

半导体靶材行业市场深度调研及发展趋势与投资前景研究报告(2026-2031版)

报告简介

高纯溅射靶材是伴随着半导体工业的发展而兴起的，集成电路产业成为目前高纯溅射靶材的主要应用领域之一。随着信息技术的飞速发展，要求集成电路的越来越高，电路中单元器件尺寸不断缩小，元件尺寸由毫米级到微米级，再到纳米级。每个单元器件内部由衬底、绝缘层、介质层、导体层及保护层等组成，其中，介质层、导体层甚至保护层都要用到溅射镀膜工艺，因此溅射靶材是制备集成电路的核心材料之一。集成电路领域的镀膜用靶材主要包括铝靶、钛靶、铜靶、钽靶、钨钛靶等，要求靶材纯度很高，一般在5N(99.999%)以上。因此半导体镀膜用靶材价格昂贵。半导体靶材主要在晶圆制造和封装测试过程中使用。

据SEMI统计，溅射靶材市场约占晶圆制造材料的2.6%，约占封装材料的2.7%。全球半导体靶材市场规模与全球半导体材料市场规模变化趋势相近。预计未来几年半导体靶材市场整体稳定，仍将保持中速增长。中国半导体靶材市场相较全球市场增速更为明显，处于较快发展阶段。国内集成电路产业一直受制于人，每年大量从海外进口，进口金额居所有进口商品中第一位，超过市场上熟知的原油和铁矿石等资源品。近年来，中兴制裁事件与华为事件都给我们敲响警钟，芯片等核心技术产业亟需发展，国产替代刻不容缓。作为半导体材料中的重要一环—溅射靶材同样如此，国产化是必然之路也是唯一之路。

本研究咨询报告由北京中道泰和信息咨询有限公司领衔撰写，在大量周密的市场调研基础上，主要依据了国家统计局、国家商务部、国家发改委、国家经济信息中心、国务院发展研究中心、工信部、SEMI、中国电子材料行业协会、51行业报告网、全国及海外多种相关报纸杂志的基础信息等公布和提供的大量资料和数据，客观、多角度地对中国半导体靶材市场进行了分析研究。报告在总结中国半导体靶材发展历程的基础上，结合新时期的各方面因素，对中国半导体靶材的发展趋势给予了细致和审慎的预测论证。报告资料详实，图表丰富，既有深入的分析，又有直观的比较，为半导体靶材企业在激烈的市场竞争中洞察先机，能准确及时的针对自身环境调整经营策略。

报告目录

第一章 半导体靶材行业界定和分类

第一节 行业基本概念

第二节 行业基本特点

第三节 行业分类

第二章 2021-2026年半导体靶材行业国内外发展概述

第一节 全球半导体靶材行业发展概况

一、全球半导体靶材行业发展现状

二、全球半导体靶材行业发展趋势

三、主要国家和地区发展状况

第二节 中国半导体靶材行业发展概况

一、中国半导体靶材行业发展历程与现状

二、中国半导体靶材行业发展中存在的问题

第三章 2021-2026年中国半导体靶材行业发展环境分析

第一节 宏观经济环境

第二节 宏观政策环境

第三节 半导体靶材行业政策环境

第四节 半导体靶材行业技术环境

第四章 2021-2026年中国半导体靶材行业市场分析

第一节 市场规模

一、半导体靶材行业市场规模及增速

二、半导体靶材行业市场饱和度

三、影响半导体靶材行业市场规模的因素

四、2026-2031年半导体靶材行业市场规模及增速预测

第二节 市场结构

第三节 市场特点

一、半导体靶材行业所处生命周期

二、技术变革与行业革新对半导体靶材行业的影响

三、差异化分析

第五章 中国半导体靶材行业供给与需求情况分析

第一节 2021-2026年中国半导体靶材行业总体规模

第二节 中国半导体靶材行业盈利情况分析

第三节 中国半导体靶材行业供给概况

一、2021-2026年中国半导体靶材供给情况分析

二、2021-2026年中国半导体靶材行业供给特点分析

三、2026-2031年中国半导体靶材行业供给预测分析

第四节 中国半导体靶材行业需求概况

一、2021-2026年中国半导体靶材行业需求情况分析

二、2021-2026年中国半导体靶材行业市场需求特点分析

三、2026-2031年中国半导体靶材市场需求预测分析

第五节 半导体靶材产业供需平衡状况分析

第六章 2021-2026年中国半导体靶材行业区域市场分析

第一节 区域市场分布状况

第二节 重点区域市场需求分析

第三节 区域市场需求变化趋势

第七章 2021-2026年中国半导体靶材行业产业链分析

第一节 半导体靶材行业产业链分析

一、产业链结构分析

二、主要环节的增值空间

三、与上下游行业之间的关联性

第二节 半导体靶材上游行业分析

一、半导体靶材成本构成

二、上游行业发展现状

三、2026-2031年上游行业发展趋势

四、上游行业对半导体靶材行业的影响

第三节 半导体靶材下游行业分析

一、半导体靶材下游行业分布

二、下游行业发展现状

三、2026-2031年下游行业发展趋势

四、下游需求对半导体靶材行业的影响

第八章 2021-2026年中国半导体靶材行业主导驱动因素分析

第一节 国家政策导向

第二节 关联行业发展

第三节 行业技术发展

第四节 行业竞争状况

第五节 社会需求的变化

第九章 2021-2026年中国半导体靶材行业偿债能力分析

第一节 半导体靶材行业资产负债率分析

第二节 半导体靶材行业速动比率分析

第三节 半导体靶材行业流动比率分析

第四节 2026-2031年半导体靶材行业偿债能力预测

第十章 2021-2026年中国半导体靶材行业营运能力分析

第一节 半导体靶材行业总资产周转率分析

第二节 半导体靶材行业净资产周转率分析

第三节 半导体靶材行业应收账款周转率分析

第四节 半导体靶材行业存货周转率分析

第五节 2026-2031年半导体靶材行业营运能力预测

第十一章 2021-2026年中国半导体靶材行业竞争分析

第一节 重点半导体靶材企业市场份额

第二节 半导体靶材行业市场集中度

第三节 行业竞争群组

第四节 潜在进入者

第五节 替代品威胁

第六节 供应商议价能力

第七节 下游用户议价能力

第十二章 2021-2026年中国半导体靶材行业重点企业分析

第一节 宁波江丰电子材料股份有限公司

一、企业概述

二、企业主要经济指标

三、企业盈利能力分析

四、企业偿债能力分析

五、企业发展优势分析

第二节 有研新材料股份有限公司

一、企业概述

二、企业主要经济指标

三、企业盈利能力分析

四、企业偿债能力分析

五、企业发展优势分析

第三节 隆华科技集团(洛阳)股份有限公司

一、企业概述

二、企业主要经济指标

三、企业盈利能力分析

四、企业偿债能力分析

五、企业发展优势分析

第四节 福建阿石创新材料股份有限公司

一、企业概述

二、企业主要经济指标

三、企业盈利能力分析

四、企业偿债能力分析

五、企业发展优势分析

第五节 贵研铂业股份有限公司

- 一、企业概述
- 二、企业主要经济指标
- 三、企业盈利能力分析
- 四、企业偿债能力分析
- 五、企业发展优势分析

第六节 安泰科技股份有限公司

- 一、企业概述
- 二、企业主要经济指标
- 三、企业盈利能力分析
- 四、企业偿债能力分析
- 五、企业发展优势分析

第七节 芜湖长信科技股份有限公司

- 一、企业概述
- 二、企业主要经济指标
- 三、企业盈利能力分析
- 四、企业偿债能力分析
- 五、企业发展优势分析

第八节 云南锡业股份有限公司

- 一、企业概述
- 二、企业主要经济指标
- 三、企业盈利能力分析

四、企业偿债能力分析

五、企业发展优势分析

第九节 宁夏东方钽业股份有限公司

一、企业概述

二、企业主要经济指标

三、企业盈利能力分析

四、企业偿债能力分析

五、企业发展优势分析

第十节 河南豫光金铅股份有限公司

一、企业概述

二、企业主要经济指标

三、企业盈利能力分析

四、企业偿债能力分析

五、企业发展优势分析

第十三章 2026-2031年中国半导体靶材行业发展与投资风险分析

第一节 半导体靶材行业环境风险

一、国际经济环境风险

二、汇率风险

三、宏观经济风险

四、宏观经济政策风险

五、区域经济变化风险

第二节 产业链上下游及各关联产业风险

第三节 半导体靶材行业政策风险

第四节 半导体靶材行业市场风险

一、市场供需风险

二、价格风险

三、竞争风险

第十四章 2026-2031年中国半导体靶材行业发展前景及投资机会分析

第一节 半导体靶材行业发展前景预测

一、用户需求变化预测

二、竞争格局发展预测

三、渠道发展变化预测

四、行业总体发展前景及市场机会分析

第二节 半导体靶材行业投资机会

一、区域市场投资机会

二、产业链投资机会

第十五章 研究结论及发展建议

第一节 半导体靶材行业研究结论及建议

第二节 中道泰和半导体靶材行业发展建议

一、行业发展策略建议

二、行业投资方向建议

三、行业投资方式建议

图表目录：

图表：2021-2026年全国半导体靶材市场规模情况

图表：全球半导体靶材行业市场竞争格局情况

图表：全球半导体靶材行业市场地区分布情况

图表：溅射技术发展至今经历六大阶段

图表：靶材的基本制备工艺

图表：国内外核心靶材技术差距

图表：靶材设计面临的工艺问题

图表：2021-2026年h1国内生产总值情况

图表：宏观政策环境

图表：半导体集成电路扩散阻挡层

图表：金属层间的通孔和接触孔的钨塞填充

图表：半导体用钨材料中的杂质含量要求

图表：不同致密度钨靶材与其溅射的薄膜的表面形貌：(a)82.5%致密度靶材;(b)99.5%致密度靶材;(c)82.5%致密度靶材溅射的薄膜;(d)82.5%致密度靶材溅射的薄膜

图表：全球半导体靶材市场规模

图表：2021-2026年我国半导体靶材市场规模及增速

图表：2026-2031年半导体靶材行业市场规模预测

图表：芯片靶材：铜、钽、铝、钛四种为主

图表：靶材产业链各环节呈金字塔型分布

图表：行业生命周期理论(industry life cycle)图例

图表：钴、铜、钨、铝靶材的物理特性

图表：芯片生产过程中“薄膜沉积”和“封装”环节用到靶材

图表：2021-2026年我国半导体靶材市场规模

图表：江丰电子毛利率情况

图表：国内外半导体用靶材供应商简介

图表：国内12寸线统计

图表：大基金二期将加码上游材料，靶材市场或将受益

图表：半导体靶材市场需求分布

图表：半导体靶材行业产业链

图表：半导体靶材溅射原理图

图表：半导体用金属靶材

图表：半导体靶材行业成本分布构成情况

图表：半导体靶材上游种类

图表：半导体用靶材简介

图表：靶材相关政策

图表：靶材行业在产业链中的作用

图表：靶材工艺流程

图表：海外主要靶材商

图表：全球半导体靶材市场规模(亿美元)

图表：半导体靶材行业资产负债率

图表：半导体靶材行业速动比率

图表：半导体靶材行业流动比率

图表：2026-2031年半导体靶材行业偿债能力预测

图表：半导体靶材行业总资产周转率

图表：半导体靶材行业净资产周转率

图表：半导体靶材行业应收账款周转率

图表：半导体靶材行业行业存货周转率

图表：全球靶材主要厂商份额

图表：2021-2026年江丰电子业绩情况

图表：江丰电子归属净利润情况

图表：江丰电子盈利能力指标

图表：江丰电子偿债能力指标

图表：2021-2026年有研新材主要经济指标

图表：2021-2026年有研新材业绩情况

图表：有研新材归属净利润情况

图表：有研新材盈利能力指标

图表：有研新材偿债能力指标

图表：2021-2026年隆华科技主要经济指标

图表：2021-2026年隆华科技绩情况

图表：隆华科技归属净利润情况

图表：隆华科技盈利能力指标

图表：隆华科技偿债能力指标

图表：2021-2026年阿石创主要经济指标

图表：2021-2026年阿石创绩情况

图表：阿石创归属净利润情况

图表：阿石创盈利能力指标

图表：阿石创偿债能力指标

图表：2021-2026年贵研铂业主要经济指标

图表：2021-2026年贵研铂业绩情况

图表：贵研铂业归属净利润情况

图表：贵研铂业盈利能力指标

图表：贵研铂业偿债能力指标

图表：2021-2026年安泰科技主要经济指标

图表：2021-2026年安泰科技绩情况

图表：安泰科技归属净利润情况

图表：安泰科技盈利能力指标

图表：安泰科技偿债能力指标

图表：2021-2026年长信科技主要经济指标

图表：2021-2026年长信科技绩情况

图表：长信科技归属净利润情况

图表：长信科技盈利能力指标

图表：贵研铂业偿债能力指标

图表：2021-2026年锡业股份主要经济指标

图表：2021-2026年锡业股份绩情况

图表：锡业股份归属净利润情况

图表：锡业股份盈利能力指标

图表：锡业股份偿债能力指标

图表：2021-2026年东方钽业主要经济指标

图表：2021-2026年东方钽业业绩情况

图表：东方钽业归属净利润情况

图表：东方钽业盈利能力指标

图表：东方钽业偿债能力指标

图表：2021-2026年豫光金铅主要经济指标

图表：2021-2026年豫光金铅业绩情况

图表：豫光金铅归属净利润情况

图表：豫光金铅盈利能力指标

图表：豫光金铅偿债能力指标

图表：半导体靶材的企业情况

把握投资 决策经营！

咨询订购 请拨打 400-886-7071 (免长途费) Email : kf@51baogao.cn

报告编号：252132

本文地址：<https://www.51baogao.cn/baogao/20220316/252132.shtml>

在线订购：[点击这里](#)